PVD-CVD ハイブリッドプロセスによる窒素含有 DLC 膜の形成

Formation of Nitrogen-Containing DLC Film by PVD-CVD Hybrid Process ^o飯島 佑史¹, 今井 貴大¹, 磯野 凌¹, 針谷 達¹, 須田 善行¹, 滝川 浩史¹, 神谷 雅男², 瀧 真³, 長谷川 祐史³, 辻 信広³, 金子 智⁴, 國次 真輔⁵, サム イック⁶, アヴィ ベンデイビッド⁶, フィル マーティン⁶, 羽渕 仁恵⁷ (1.豊橋技科大, 2.伊藤光学, 3.オンワード技研, 4.神奈川県産技セ, 5.岡山工技セ, 6.CSIRO, 7.岐阜高専) ^oYushi Iijima¹, Takahiro Imai¹, Ryo Isono¹, Toru Harigai¹, Yoshiyuki Suda¹, Hirofumi Takikawa¹, Masao Kamiya², Makoto Taki³, Yushi Hasegawa³, Nobuhiro Tsuji³, Satoru Kaneko⁴, Shinsuke Kunitsugu⁵, Sam Yick⁶, Avi Bendavid⁶, Phil Martin⁶, Hitoe Habuchi⁷ (1.Toyohashi Univ. Technol., 2. Itoh Opt. Ind. Co., Ltd., 3. Onward Ceram. Coat. Co., Ltd., 4. Kanagawa Ind.

Technol. Cent., 5. Ind. Technol. Cent. of Okayama, 6. CSIRO, 7. Gifu Natl. Coll. Technol.) E-mail: iijima.yushi@pes.ee.tut.ac.jp

1. はじめに

ダイヤモンドライクカーボン(DLC) 膜は, 高硬度,低摩擦係数などの優れた特性から,工 具,金型の保護膜などに応用されている。さら に,DLC 膜に窒素を含有させた DLC(N-DLC) 膜は DLC 膜と比較して摩擦特性,導電性など が向上する。また,窒素含有量により光学バン ドギャップを可変できる¹⁾。本研究では,T字 状フィルタードアーク蒸着(T-FAD)法²⁾に窒 素ガスを導入することで N-DLC 膜を形成し, その膜特性を分析した。

2. 実験方法

T-FAD 装置を用いてシリコン (Si) およびガ ラス (SiO₂) 基板上にテトラヘドラルアモルフ ァスカーボン (ta-C) 膜および N-DLC 膜を形 成した。炭素源は黒鉛,窒素含有に際しては窒 素 (N₂) ガスを導入し,基板にはパルスバイア スを印加した。形成した膜について走査型X線 光電子分光分析装置 (XPS),分光エリプソメー タなどを用いて分析した。

3. 結果と考察

Fig. 1 に Si 基板上に形成した ta-C 膜および N-DLC 膜の窒素流量に対する窒素含有率と成 膜レート,プロセス圧力を示す。窒素流量増加 に伴い,窒素含有率とプロセス圧力は増加し, 成膜レートは 20 sccm で最大となった。ガス導 入のない T-FAD 法では,炭素イオンビームに よる PVD プロセスによって膜が形成される。 窒素ガスを導入することで,イオンビームによ り N_2 ガスの一部がプラズマ化し,PVD と CVD のハイブリッドプロセスとなり,成膜レートが 増加したと考えられる。 N_2 ガス流量が 60 sccm 以上になると,窒素分子がイオンビームの障壁 となり,基板到達を妨げるため成膜レートが減 少したと考えられる。

Fig.2にガラス基板上に形成した ta-C 膜および N-DLC 膜の屈折率と消衰係数を示す。ta-C



Fig. 1. Variation of nitrogen content, deposition rate, and process pressure for N_2 gas flow rate.



Fig. 2. Refractive index and extinction coefficient of DLC films fabricated with different N_2 gas flow rate.

膜と比較して,窒素を含有することにより,屈 折率,消衰係数ともに増加する傾向が得られた。

謝辞

本研究は科学研究費補助金および東海産業技術振興 財団助成金,大澤科学技術振興財団,電子回路基板技 術振興財団,内藤科学技術振興財団の支援を受けて行 われた。

参考文献

L.K.Cheah, *et al.*: Non-cryst. Solid, **242** (1998) 40.
H. Takikawa, *et al.*: Surf. Coat. Technol., **163** (2003) 368.